

可焊性测试内容有那些

产品名称	可焊性测试内容有那些
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

产品详情

可焊性测试，英文是“Solderability”。指通过润湿平衡法（wetting balance）这一原理对元器件、PCB板、PAD、焊料和助焊剂等的可焊接性能做一定性和定量的评估。对现代电子工业的1级（IC封装）和2级（电子元器件组装到印刷线路板）的工艺都需要高质量的互通连接技术，以及高质量和零缺陷的焊接工艺有极大的帮助

可焊性测试一般是用于对元器件、印制电路板、焊料和助焊剂等的可焊接性能做一个定性和定量的评估。在电子产品的装配焊接工艺中，焊接质量直接影响整机的质量。因此，为了提高焊接质量，除了严格控制工艺参数外，还需要对印制电路板和电子元器件进行科学的可焊性测试。

通过实施可焊性测试，帮助企业确定生产装配后的可焊性的好坏和产品的质量优劣。

测试标准

J-STD-002B 2003-2 元件、接线片、端子可焊性测试

J-STD-003B（2007-3）印刷电路板可焊性测试

IPC-TM-650 2.4.14金属表面可焊性

IPC-TM-650 2.6.8 热应力试验

GB/T 4677 印制板测试方法

IEC60068-2-58/ IEC60068-2-20 可焊性及热应力试验

GB2423.28 电工电子产品基本环境试验规程

GB2423.32 电工电子产品基本环境试验规程

MIL-STD-202G 方法208H 可焊性试验

MIL-STD-202G Mehtod 210F 热应力试验

MIL-STD-883G 2003.7 可焊性试验